

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-053

通富微电子股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通富微电	股票代码	002156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蒋澍	丁燕	
办公地址	江苏省南通市崇川路 288 号	江苏省南通市崇川路 288 号	
电话	0513-85058919	0513-85058919	
电子信箱	tfme_stock@tfme.com	tfme_stock@tfme.com	

2、报告期内公司从事的主要业务

（1）公司主要业务情况

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞

争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

（2）公司所处行业情况

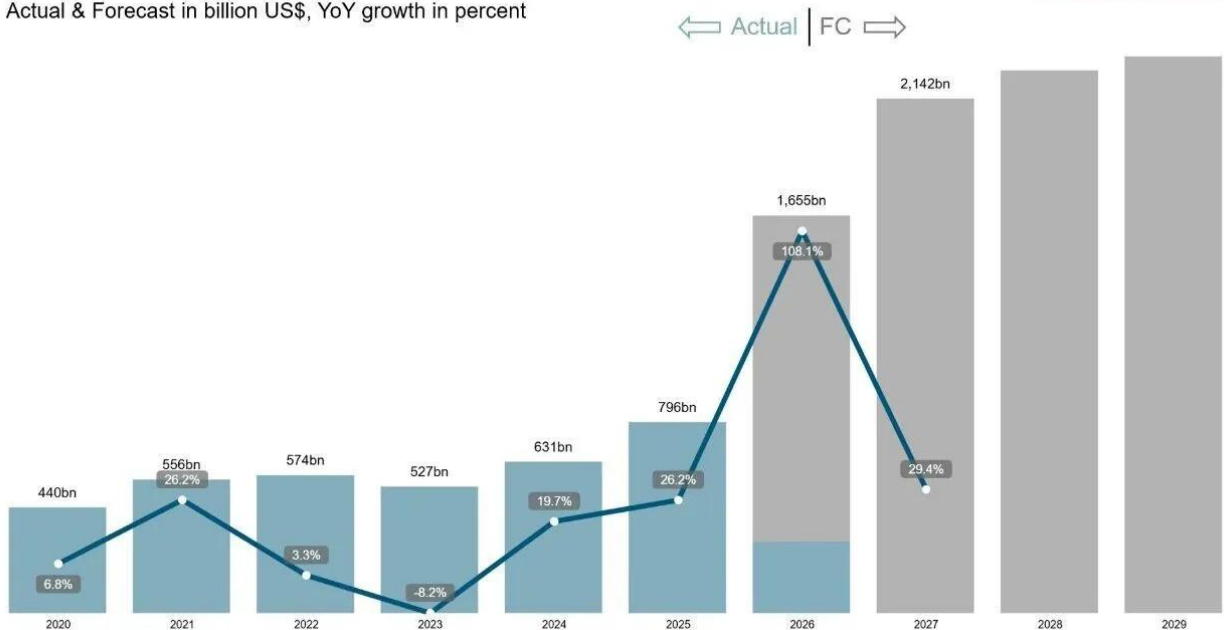
1）2026 年上半年半导体市场情况

2026 年上半年，在 AI 的驱动下，全球半导体产业进入新的超级周期，行业市场空间显著扩容。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2026 年上半年全球半导体市场营收达 7,020 亿美元，较 2025 年同期增长 102%，并预计 2026 年全年营收有望达到 1.65 万亿美元，较 2025 年全年同比增长 108%，这将是全球半导体市场首次突破 1 万亿美元大关。WSTS 表示，在人工智能基础设施、高性能计算和先进存储技术领域持续投资的推动下，半导体产业今年上半年保持强劲成长态势。其中，以存储表现最凸出，上半年营收较去年同期增长达 305%，逻辑电路产品营收也同比增长 45%。放眼国内，根据 Omdia《2026 年第二季度，半导体应用领域市场预测工具（AMFT）-中国地区》报告数据显示，2026 年中国半导体市场预计同比增长率将大幅上修至 92.9%，达 8,120.8 亿美元，相较此前预期上调了 2,656 亿美元。国内的出口数据同样显现出行业发展的强劲势头。据海关总署统计，上半年我国集成电路出口额为 1772.8 亿美元，同比大增 96%，几乎翻倍；服务器、计算机等自动数据处理设备出口上涨 41.3%，达 1380.8 亿美元。6 月当月，我国集成电路出口额达 382.1 亿美元，在整体出口额中占比 9.3%，为第一大类出口商品，对整体出口增速的拉动作用达 6.5 个百分点。

图表：2020-2029 年全球半导体市场规模及预测（单位：十亿美元）

Global semiconductor market (billion US\$)

Actual & Forecast in billion US\$, YoY growth in percent



来源：WSTS

2026 年上半年，全球半导体需求结构呈现高度分化的“AI 拉动”与“消费承压”并存格局。其中，以 AI 服务器与存储芯片为代表的算力相关需求已成为不可逆的全局增长引擎。新能源汽车销量增速放缓，转向存量结构化升级，消费电子领域持续承压。同时，全球成熟制程供给端迎来“量缩价涨”的深刻重构，国内晶圆厂正处于近年来最有利的供需格局中，我国在成熟制程领域的产能优势将进一步确立。

2026 年上半年，我国半导体终端客户呈现清晰的分层特征，高端市场以技术引领、高度定制为主，集中于 AI 服务器、智驾及折叠旗舰；中端市场注重性价比与迭代速度，体现在主流新能源汽车与智能家居领域；基础市场则以满足功能、价格优先为特征。高端市场方面，受 AI 算力需求拉动，高性能 AI 芯片及电源管理 IC、功率器件等配套芯片的需求涨势强劲。同时，智能驾驶技术向高中低端车型加速下沉以及舱驾融合芯片等新形态产品的落地，共同推动智驾芯片需求延续增长。中端市场方面，新能源汽车渗透率持续高位运行，市场逐步向存量竞争与结构升级切换。基础市场方面，

燃油车与消费电子的疲弱态势造成了结构性压力。整体而言，半导体行业的供需关系由此前的需求结构切换，逐步体现为不同技术层级、不同应用场景之间的结构性差异，供给端产能利用率分化格局持续存在。

2) 行业相关政策

2026 年上半年，国家出台了一系列政策支持半导体集成电路产业发展。

2026 年 3 月，十四届全国人大四次会议审议批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，将集成电路产业提升至国家战略核心层面，立足“自主可控、安全高效、协同发展”的核心目标，以新型举国体制为支撑，推动产业从“规模扩张”向“质量提升”转型，从“跟跑追赶”向“并跑领跑”跨越。打破产业链各环节割裂局面，推动设计、制造、封装测试、设备、材料等环节协同联动，重点强化“设备-材料-设计”全链条攻坚，推动 Chiplet、先进封装等新技术与全产业链深度融合，提升产业链整体韧性和竞争力。

2026 年 4 月，国家发展和改革委员会等部门发布《关于做好 2026 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》（发改高技〔2026〕487 号），延续集成电路分层税收优惠框架，持续落实不同制程晶圆制造企业所得税减免政策；首次清晰将集成电路关键原材料、先进封装测试企业纳入优惠申报范围，覆盖大硅片、光刻胶、靶材、封装载板、抛光材料等上游配套领域；同步衔接集成电路企业研发费用加计扣除提升政策，持续降低产业链研发与生产经营成本。文件明确清单覆盖设计、生产、特色工艺、化合物半导体、先进封测、关键材料全链条主体，稳定行业长期发展。

(3) 报告期公司经营情况

1) 抓住行业强劲成长势头，实现业务多元化增长

2026 年上半年，全球半导体市场在 AI 算力基建、高性能计算、汽车电动智能化、存储周期上行及模拟芯片国产化等多重结构性需求叠加下，延续高景气运行。公司紧扣“AI+存储+车载+国产客户”四条增长曲线，精准承接算力、存储等高增长市场领域，市场开拓与产能利用同步走强，交出“营收提速、中高端产品占比提升、利润大幅跃升”的半年答卷。

在圆片级与先进封装平台方面，公司在音频、PMIC、射频、AI 边缘芯片等领域与国内头部设计公司全面合作，薄 Die Hybrid SiP 双面封装、光电合封（CP0）技术通过可靠性验证，展现出从传统封装向“高性能+高密度+系统化”封测平台升级的技术实力。车载业务在电动化、智能座舱、底盘域控、功率半导体升级趋势下继续扩张，客户覆盖数量进一步增加，产品从车载 MCU、功率器件、车载存储延伸至智能座舱主控、底盘控制、车规级电源与传感封装；依托南通、合肥等国内基地的产能协同，公司实现对多家头部车企与 Tier1 的就近配套，车载封测收入保持高双位数增长。公司精准把握模拟芯片国产化窗口，与国内电源管理头部客户形成产能与技术战略互补，PMIC 圆片级封装、SiP、Bumping 等需求旺盛。显示驱动领域在 2025 年突破两大龙头客户基础上，2026 年上半年产值延续两位数增长，客户结构从消费电子向工业、车载显示横向拓展。2026 年上半年，通富微电在 AI 算力爆发、存储周期上行、汽车电子渗透、国产芯片转单四股力量共振下，实现了从“满产增效”到“结构提质”的半年跃迁，为全年高端封测份额提升与盈利弹性释放打下坚实基础。

2026 年上半年，公司大客户 AMD 的营收和盈利均创下历史新高，其中数据中心业务营收同比增长了一倍以上。随着 EPYC 处理器需求加速增长、Instinct 产品部署规模扩大以及 Helios 项目开始提速，AMD 正带着强劲势头迈入下半年。2026 年第二季度，AMD 数据中心部门的收入为 67 亿美元，较上年同期的 32.4 亿美元增长 107%，这主要得益于市场对 AMD EPYC 处理器和 AMD Instinct GPU 的需求；客户端与游戏业务部门营收 38 亿美元，同比增长 6%；其中，客户端业务营收为 31 亿美元，较上年同期的 25 亿美元增长 23%，主要受 AMD Ryzen 处理器需求推动。大客户 AMD 业务强劲增长，也为公司的营收规模提供了有力保障。2026 年上半年，通富超威苏州、通富超威槟城延续 2025 年高质量发展态势，紧抓全球 AI 与高端服务器产业红利，经营业绩、运营管理、产能布局、技术研发及智能制造均取得阶段性突破。经营业绩层面，通富超威苏州、通富超威槟城整体上半年营收创历史新高。苏州工厂和槟城工厂协同发力，对国内与海外市场精准布局，有效承接增量订单，持续优化盈利结构。运营管理方面，通过两家工厂资源整合、流程对标改善，稳步提升生产效率、严控生产成本，产品品质与客户满意度持续向好。同时完善人才梯队建设，为业务增长筑牢运营与人才支撑。苏州工厂和槟城工厂产能端紧扣 AI、高算力产品增长需求，持续推进高端产能扩充、生产空间拓展与设备升级，优化高端封测产能布局，有效解决产品交付瓶颈，进一步提升高端产品交付能力与市场竞争力。同时，技术研发持续前瞻布局，在 2025 年 3nm 工艺投产基础上，重点攻坚 2nm 技术节点，依托优质客户资源积累先进技术储备。上半年累计申请专利

38 项、软著 20 项，持续构筑差异化技术壁垒。在智能制造领域持续升级，以人工智能赋能生产运营，将智能技术融入生产核心场景，实现提质、增效、优化人员配置的多重成效，推动生产模式向智能化、数字化进阶。

得益于公司战略精准定位和经营策略的有效执行，2026 年上半年，公司实现营业收入 160.41 亿元，同比增长 23.03%；公司归属于上市公司股东的净利润 17.17 亿元，同比增长 316.77%。未来，公司将持续深耕主业，推进产能扩建、先进工艺落地与智能体系升级，强化全球化协同优势，稳固行业核心竞争力，保障业务持续稳健增长。

展望 2026 年下半年，业界分析认为，AI 需求仍是半导体行业景气上行的核心驱动力。以 AI 眼镜、AI 穿戴/耳机、智能家居等为代表的新兴 AI 终端需求正快速提升。细分领域景气度将出现明显分化，具备 AI 交互与场景创新属性的新兴硬件有望成为结构性增量来源，驱动消费电子产业链进入“存量替代与增量突破”并行的新阶段。同时，AI 大模型正从千亿参数向万亿参数迭代、高性能 GPU 算力密度持续提升、高带宽存储作为算力配套需求快速增长，三者共同对芯片 I/O 密度、存储带宽、异构集成能力提出更高要求，进一步推动先进封装市场持续扩张。未来，在摩尔定律趋近物理极限叠加国内先进晶圆制程外部约束的背景下，封装从传统后道“保护+引脚引出”的配套工序，升级为“靠异质集成、芯粒拼接延续芯片性能爬坡”的核心路径。这种定位抬升使封测行业跳出传统封测的同质化竞争，拿到和晶圆厂、芯片设计公司同等协同的话语权，也能承接国产算力芯片、AI 芯片的自主化封装需求，将成为国内半导体产业链绕开单点制程卡脖子的关键突破口。

2) 公司技术研发水平不断精进

2026 年上半年，公司在技术研发方面取得诸多进展。

2D+多维堆叠高性能先进封装技术方面，公司深耕 2D+多维堆叠先进封装，以 VISIONS™ 平台为核心支撑，集成硅中介层、垂直堆叠及嵌入式多桥接等多元技术方案，实现多颗 Chiplet 异构集成与更高互连密度、更优能效比。技术层面，硅通孔（TSV）间距持续微缩，散热与翘曲控制达行业领先水平。

公司坚定将高性能先进封装作为突破摩尔定律、提升芯片系统性能的关键路径。2026 年上半年，先进封装业务营收占比稳步提升，多款产品已批量导入高性能计算、推理芯片等领域。

光电融合领域，公司推进光电合封（CP0）技术攻关，基于先进封装平台构建光电子集成电路（PIC）与电子集成电路（EIC）异构集成能力，已为多个客户提供多元化解决方案，有力支撑下一代数据中心 1.6T 及以上速率的低功耗互连需求。

在存储器（Memory）方面，公司在高堆叠封装赛道上，完成 LPDDR 16DP 和 rNand 64DP 产品技术方案开发，巩固存储封装龙头地位。在垂直打线先进封装技术方面，VF0 成功实现了首次 ES 封装交付，VCS 全线工艺验证完成，在三位维集成领域迈出关键一步。

前沿布局方面，公司正积极布局混合键合（Hybrid Bonding）技术，突破传统微凸块密度极限，实现亚微米级无凸块互连。

公司秉持创新驱动发展战略，深耕技术研发与自主创新。截至 2026 年 6 月 30 日，集团累计专利申请超 1,800 件，授权专利总量超 800 项，知识产权矩阵持续扩容，为企业技术积累与产品迭代奠定了坚实基础。

3) 重大工程建设稳步推进，拓展长远发展空间

2026 年上半年，公司紧扣整体战略发展规划，全力推动各生产基地改扩建及基础设施配套工程落地实施。崇川工厂、通富通科、厦门通富、通富超威苏州、通富超威槟城各生产基地改造工程有序推进，累计完成改造面积约 3.9 万平方米，在建项目规模约 14 万平方米，持续优化各厂区生产布局；配套设施方面，苏州及槟城两地 110KV 新建变电站项目建设工程稳步开展，项目投运后将显著补强基地供电能力，为集团产能扩张提供可靠电力支撑。

4) 聚力组织提效，厚植人才根基

2026 年上半年，公司紧扣“有序、高效、受控”方针，积极响应国家集成电路产业发展战略，深度落地 2026 集成电路生态链协同与高质量发展大会核心部署，将“感恩奋进、乘势而上、合作共赢”理念融入人力资源管理中。持续推进管理流程优化，夯实组织能力与人才底盘，聚焦人才梯队建设与多元激励，持续打造高韧性人才体系，有力支撑先进封装战略落地。

①坚持架构与战略需求深度适配，紧扣十五五产业战略布局与集成电路产业高质量发展大势，围绕端到端战略主航道，推动组织从“单组合力”升级为“整体合力”，强化全域链资源整合与规模效应，持续提升组织穿透力与战略协同能级，让营销听得见炮火，让研发看得见市场，让生产守得住底线，让组织真正服务于核心任务，以高效组织协同适配

半导体产业新周期、先进封装规模化普及的行业趋势，确保战略有序推进与业务成果持续领先。

②围绕核心技术与重点业务方向，公司统筹推进外部引才与内部育才工作。立足产业创新攻坚、高端人才培养的产业协同发展要求，持续落地六边形人才模型，拓宽行业专家引进、校招及校企合作渠道，夯实大学生人才池，健全应届生全周期培育机制；依托干部培养、导师带教分层赋能，优化青年干部与工程技术人才梯队，不断充实关键领域人才储备。

③激励体系持续优化，坚持绩效与利润导向，完善差异化考核分配机制，统筹短期绩效激励与长期人才留任，激发全员提质增效活力。推进人力资本数字化管理，以数据驱动人效提升，落实向管理要效益，锚定“科技为基、产业为柱、文化为魂”发展要义，凝聚企业高质量发展内生动力。

站在“十五五”新征程的起点上，公司将勇担科技自立自强历史责任，凝心聚力、创新攻坚，久久为功，推动组织、人才、激励体系协同联动，持续将人才优势转化为业务竞争优势，积极发挥产业联结者、共建者、赋能者作用，为集团高质量发展提供稳定坚实的人才支撑。

3、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	16,041,019,909.75	13,038,246,156.27	23.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,717,458,597.00	412,092,154.12	316.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	747,461,286.61	420,437,486.81	77.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,932,766,961.74	2,480,182,511.26	18.25%
基本每股收益（元/股）	1.1317	0.2715	316.83%
稀释每股收益（元/股）	1.1317	0.2715	316.83%
加权平均净资产收益率	10.54%	2.77%	7.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	51,527,231,727.42	47,266,459,661.25	9.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,842,420,161.37	15,493,795,234.49	8.70%

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		561,305	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
南通华达微电子集团股份有限公司	境内非国有法人	18.80%	285,344,715	0	不适用	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	5.00%	75,879,745	0	不适用	0
香港中央结算有限	其他	3.89%	59,057,034	0	不适用	0

公司						
苏州园丰资本管理有限公司—苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）	其他	1.00%	15,177,365	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	9,326,477	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.43%	6,500,000	0	不适用	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	国有法人	0.40%	6,111,385	0	不适用	0
中信银行股份有限公司—交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	5,740,592	0	不适用	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	0.33%	5,059,997	0	不适用	0
国泰海通证券股份有限公司—国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.29%	4,437,799	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，第 1 大股东与其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用				

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒适用 ☐不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
通富微电子股份有限公司 2026 年度第一期科技创新债券	26 通富微电 SCP001(科创债)	012680312.IB	2026 年 01 月 28 日	2026 年 10 月 26 日	20,000	1.77%
通富微电子股份有限公司 2026 年度第二期科技创新债券	26 通富微电 MTN002(科创债)	102681560.IB	2026 年 04 月 21 日	2029 年 04 月 22 日	30,000	2.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	64.14%	63.73%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	17.68	10.03

三、重要事项

无